

高性能ICパッケージ・ コンバータ&アダプタ

SMT相互接続の物理的制約を克服
するエンジニアリング・ソリューション

Ironwood Electronics





ミッション・クリティカルな 環境で証明された絶対的 信頼性

Ironwood Electronicsのソリューションは、極限の環境下での動作が求められる「軍事（Military）」および「宇宙開発（Aerospace）」分野のアプリケーションで採用されています。

妥協が許されないプロジェクトにおける、最高峰の耐久性とパフォーマンス。

数値で見るIronwood Electronicsの実績

20+



業界における専門的な
実績と経験（年）

6,000+



現在提供している
製品ラインナップ数

1 / Day



毎日平均でスタートする
新規カスタム設計の数

Eng



SMT相互接続に特化した機械・
電気エンジニアの専門チーム

あらゆるパッケージ要件に対応する包括的ソリューション

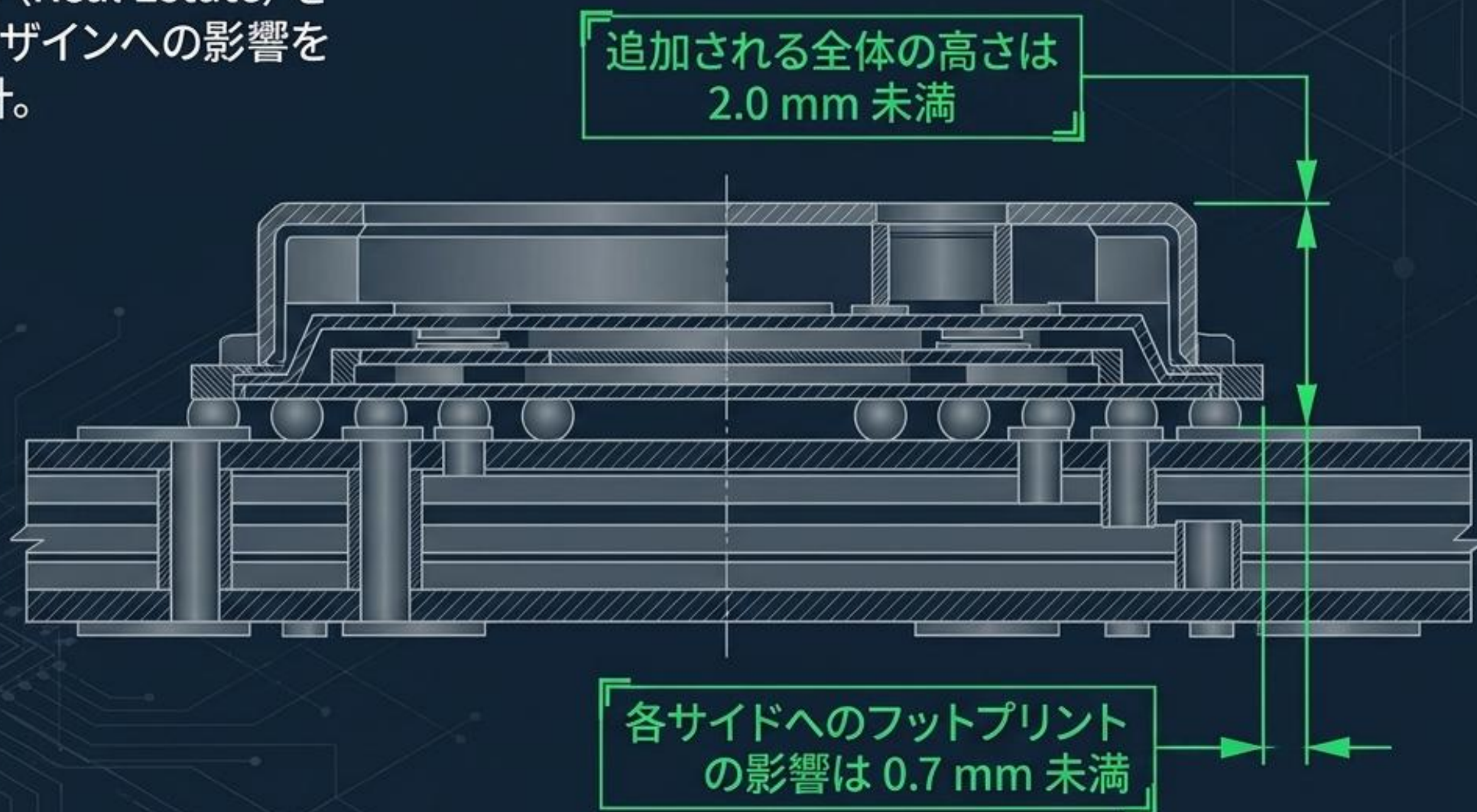
SMT相互接続のスペシャリストとして、主要な全パッケージタイプを網羅



数百種類の標準品に加え、
豊富なカスタム設計の実績。

極薄・低フットプリントによる空間の最適化

基板上の限られたスペース (Real Estate) を最大限に活用し、既存のデザインへの影響を最小限に抑える物理的設計。



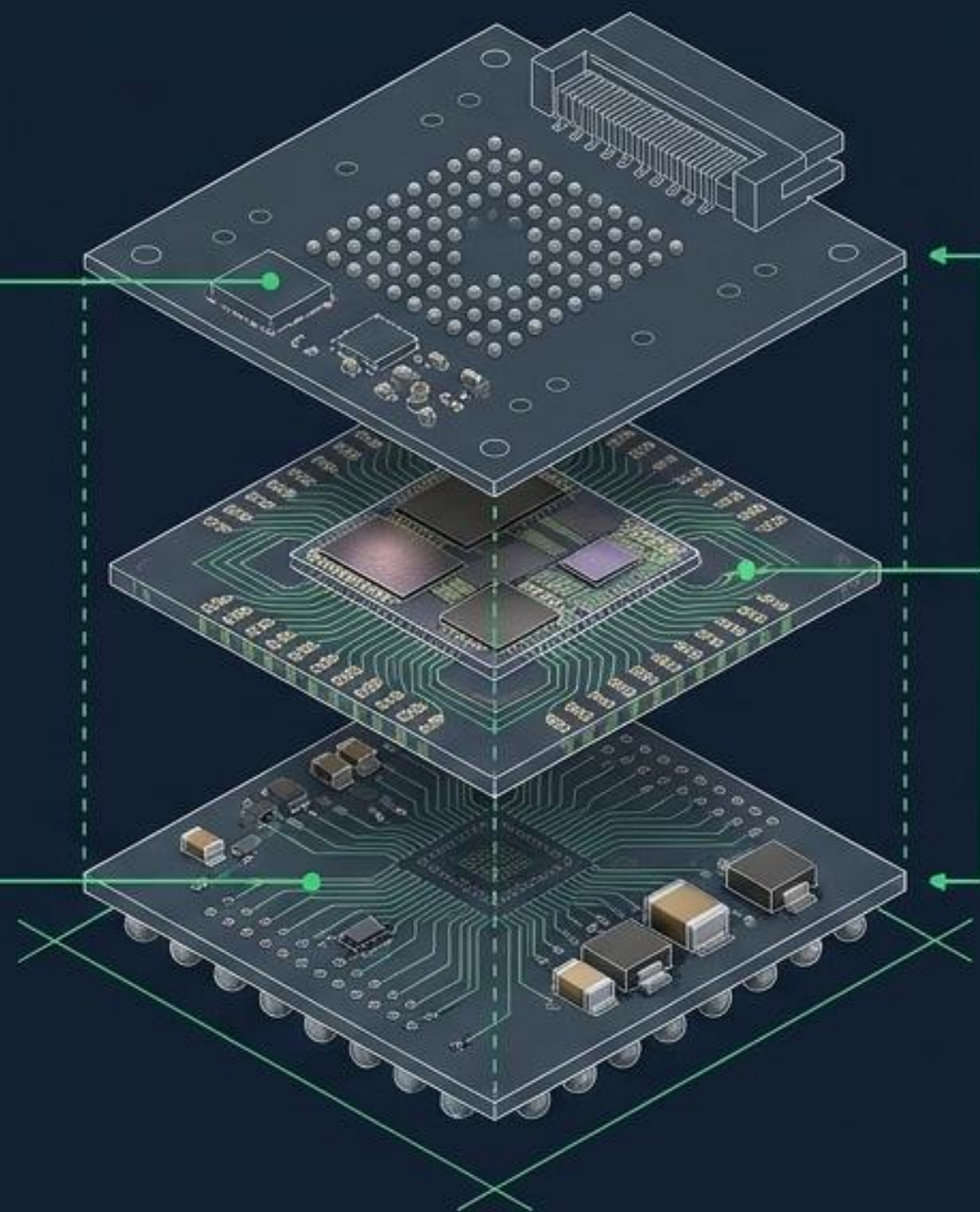
単なる変換を超える高度な統合設計

Voltage Regulation

オンボードの電圧レギュレータ
(Voltage Regulation) を統合可能

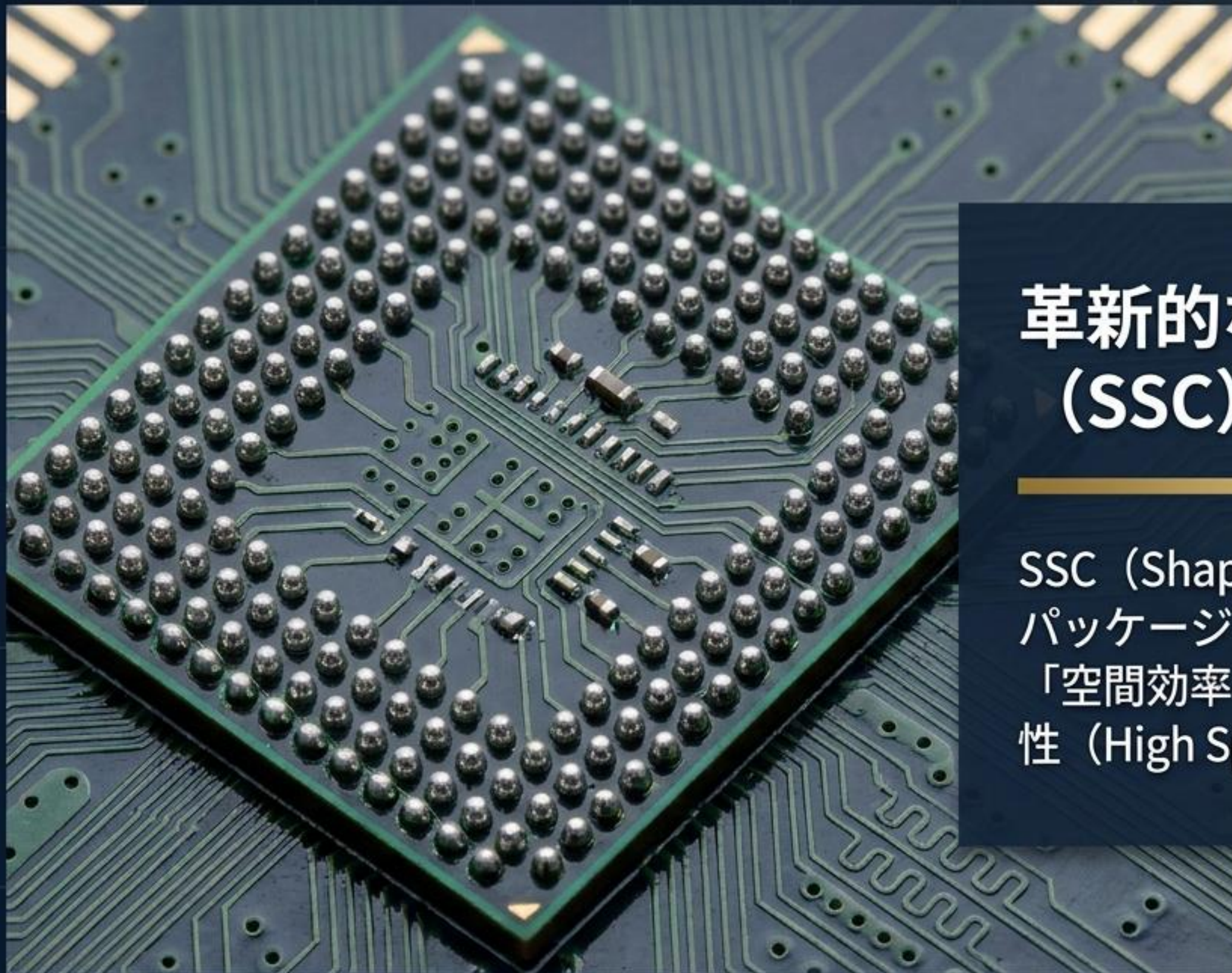
Capacitors

バイパスコンデンサ等の
オンボード実装



Multi-chip / Multi-layer

マルチチップおよびマルチレイ
ヤーアーキテクチャへの対応



革新的な「成形ハンダコラム (SSC) 技術」

SSC (Shaped Solder Column) を搭載した
パッケージ・コンバータは、圧倒的な
「空間効率 (Space Efficiency)」と「高速
性 (High Speed)」を同時に実現します。

SSC技術の実装メカニズムと利便性

A

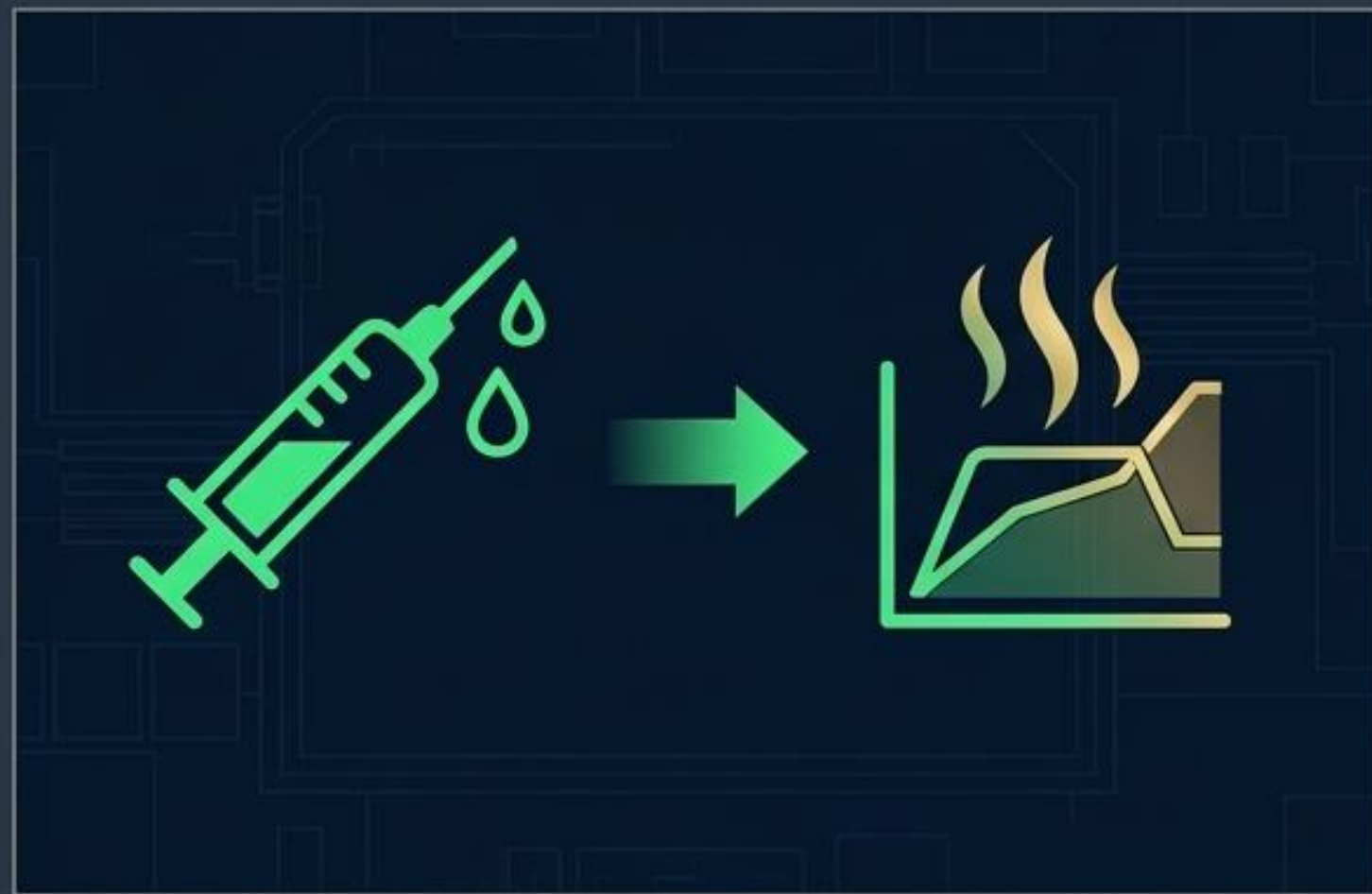
マッチング (Matching)



ターゲットとなるランドパターン (Land Pattern) に正確に一致。

B

アタッチメント (Attachment)



シンプルなフラックス塗布とリフロー (Flux & Reflow) による簡単な実装プロセス。

SSCがもたらす3つの事業価値



圧倒的な耐久性 (Tough & Durable)

軍事（MIL）アプリケーションで実際に使用され、その堅牢性と耐久性が証明されています。



コスト効率 (Cost Effective)

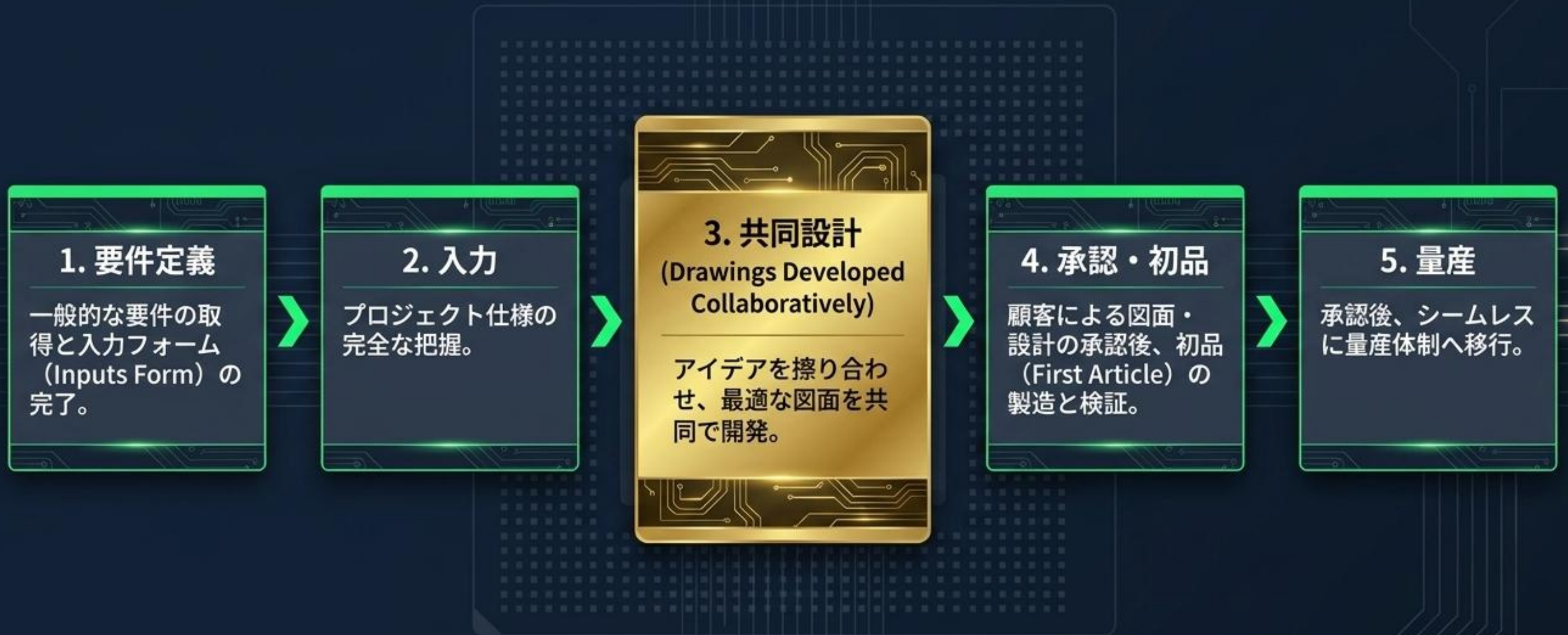
中～大量生産（Moderate to High Volume）のスケールにおいて、非常に優れた費用対効果を発揮します。



実証済みの性能 (Proven Performance)

過酷な環境下でも妥協のない信頼性（Reliability）とパフォーマンスを提供します。

共同設計を中核としたアジャイル開発プロセス



プロトタイプから量産までを支える自社一貫体制



クイックターン (Quick Turn) でのプロトタイプ製造から、大規模な量産 (Volume Applications) まで、一貫した品質とスピードで対応。

Ironwoodアドバンテージ：妥協なきエンジニアリングの結集

専門的エンジニアリング (Expert Engineering)

SMTインターフェースに
特化した高度な技術力。

物理的優位性 (Physical Superiority)

高さ<2.0mm、フットプ
リント影響<0.7mmの
極薄設計。

パッケージ・ コンバータの 最適解

独自技術 (Proprietary Tech)

空間効率と高速性を両立する
SSC (成形ハンダコラム)。

絶対的信頼 (Absolute Trust)

MILスペック基準を満たす
耐久性と、共同設計によ
る確実なデリバリー。

次世代の基板設計を共に実現するパートナー

20年以上の実績と、毎日生み出される新しいカスタム設計。
物理的制約を克服し、ミッション・クリティカルな要件を満たす
最適なICパッケージ・コンバータを、私たちと共に設計しませんか。

お問い合わせは Ironwood Electronics社
正規代理店
株式会社ミライ まで
info@miraicorporation.com